

JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会2016

(旧 鉛フリー化活動 成果報告会)

日 時 平成28年7月14日(木) 10:00~17:00 (受付開始 9:30~)
場 所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
主 催 一般社団法人 電子情報技術産業協会
企 画 JEITA/実装技術標準化専門委員会

P

rogram

司 会 山本 克己 氏 テクノオフィス・ヤマモト

10:00~10:05	主催者挨拶 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 (株)東芝
10:05~10:10	来賓挨拶 瀬川 雅也 氏 経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 課長補佐
10:10~10:30	「部品内蔵基板設計データフォーマットの国際標準化」の取り組みについて 小島 智 氏 コジマ イーデザイン オフィス
10:30~11:00	METIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電気的試験方法に関する国際標準化」の取り組みについて 松澤 浩彦 氏 部品内蔵技術標準化研究委員会 (株)図研
11:00~11:30	熱設計の最新動向と課題 福江 高志 氏 岩手大学 理工学部 熱工学研究室 助教 平沢 浩一 氏 KOA(株) 技創リセンター
11:30~12:00	JEITAでの高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組みについて 芹沢 弘二 氏 高温鉛入りはんだ代替金属材料WG 主査 千住金属工業(株)
休 憩 (昼食は各自にてお願い致します)	
13:00~13:30	SiCパワーデバイスとその応用の最新動向 四戸 孝 氏 (株)東芝 研究開発センター 参事
13:30~13:45	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関する国際標準化』の取り組み状況 岡本 正英 氏 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 副委員長 (株)日立製作所
13:45~14:15	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関する国際標準化』 ディスクリートタイプパワーデバイスWGの取り組み 高橋 邦明 氏 ディスクリートタイプパワーデバイスWG 幹事 エスペック(株) テストコンサルティング本部
14:15~14:45	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関する国際標準化』 モジュールタイプパワーデバイスWGの取り組み 荻谷 義治 氏 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 委員長 芝浦工業大学 教授
休 憩	
15:00~15:30	EU-RoHS指令の適用除外見直し動向(高融点はんだを中心に) 小畑 康弘 氏 欧州化学品規制WG ハンダad-hoc 主査 パナソニック(株) 品質・環境本部 主幹
15:30~16:00	IEC 60068-2-82「電気・電子部品のウィスカ試験方法」改定活動 坂本 一三 氏 ウィスカ試験方法研究会 副主査 オムロン(株)
16:00~16:30	低温実装におけるウィスカ発生検証実験の結果について 佐々木喜七 氏 沖エンジニアリング(株)
16:30~17:00	はんだ接合耐久性に関わる試験方法標準化の取り組みについて 山本 剛 氏 富士通アドバンストテクノロジー(株)

プログラムの内容につきましては、変更となる場合もありますので、予めご承知おきください。

ご挨拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年からはんだの鉛フリー化に代表されます、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA環境調和型先端実装技術 成果報告会』として、この一年間の先端的な実装技術の検討結果をご報告させていただきます。

今回は、METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」および「パワーデバイス実装に関する国際標準化」をはじめ、三次元電子モジュールの外形及び電気的試験方法に関する国際標準化活動、高温はんだ・合金等の適用除外規定見直しに関するEU-RoHS指令の動向、高温はんだの鉛フリー化、電気・電子部品のウィスカ試験方法改定の動きとその影響について等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

他にも、機器の小型化に伴い重要性が増してきていますサーマルマネジメントについて、現状の課題と標準化への取り組みについての報告、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動として、現在主流になっている錫-銀-銅系鉛フリーはんだの接合寿命予測等についての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 二宮 良次〔(株)東芝〕

参加要領

■日 時 平成28年7月14日(木) 10:00~17:00 (受付開始9:30~)

■場 所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
東京都江東区豊洲3-7-5
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

■申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
登録完了後、登録E-mailアドレスに確認メールをお送り致します。
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。
申込書は以下リンクからダウンロードください。
http://home.jeita.or.jp/tss/2016kankyochowa_EntrySheet.xls
(本状下部の申込書に記入の上、FAXでお送り頂いても結構です。)

■申込期限 平成28年7月7日(木) 必着

■定 員 100名
(定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込みください。)

■参加費 会員 10,000円(税込)
一般 15,000円(税込)

■配布資料 成果報告書(当日配布致します)

■お問合せ先 一般社団法人 電子情報技術産業協会
知的基盤部 標準G(岩淵・塩川・澤田)
TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

会場へのアクセス



最寄駅のご案内: 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分
JR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分

(一社)電子情報技術産業協会／知的基盤部行
FAX:03-5218-1078 E-mail:tsc4@jeita.or.jp

「環境調和型先端実装技術 成果報告会2016」参加申込書

貴社名	会員確認	会員・一般(非会員) (いずれかに○を付けてください。)
-----	------	---------------------------------

※ 会員／一般(非会員)の確認は、JEITA会員一覧<<http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>>でお願い致します。

参加者氏名	所属役職名
連絡先住所 (〒)	
TEL番号	FAX番号
E-mail	

※ 複数名の参加申込みの場合は、以下にご記入ください。(受講票と請求書は参加者ごとに個別にお送り致します。)

参加者氏名	所属役職名
連絡先住所 (〒)	
TEL番号	FAX番号
E-mail	